

半自动剥膜机



剥膜机是专门用于晶圆、PCB、QFN等产品切割完之后的剥离，该机能方便、高效、快速的将切割后的单颗器件从粘性膜上分离下来，且不会损伤器件本身，更有效的提高工作效率

产品特点:

适用于蓝膜、UV膜、PET衬底膜及其它单/双层膜;

- 配备调速伺服电机，控制晶粒间距;
- 剥膜刀口间距可调整，适应不同厚度的膜;
- QFN机型，剥离后，产品直接承接在方盒内（定制）
- 机台质量可靠、性能稳定;

型号		DM-100	DM-200	DM-300-F	单位	备注
规格参数	适用产品尺寸	3~6	3~8	定制	Inch	可定制特殊品
	晶粒尺寸范围	0.5~5	0.5~5	0.5~5	Mm	
	适应膜的种类	UV膜、蓝膜	UV膜、蓝膜	UV膜、蓝膜		
	适用胶膜厚度	0.05~0.15	0.05~0.15	0.05~0.15	Mm	
	机器尺寸	800*550*400	900*550*400	800*550*400	Mm	
动力	电源	单相AC 220	单相AC 220	单相AC 220	V	
	功率	80	90	60	W	
	设备重量	80	120	100	Kg	

备注：根据客户产品及使用的差异，如有特殊要求，购买前请于我司业务人员联系

期待与您合作！

如有疑问，可联系我司业务人员

苏州红杨微电子有限公司

联系人：魏红兵（13606137535）

E-Mail:adam@rpms.com.cn

地址：江苏苏州西环路883蓝文化创意产业园